



次世代配線板研究会 2023年度第1回公開研究会

主催：次世代配線板研究会

◆公開研究会のご案内

研究会テーマ「Landless Via(ランドレスビア)の有効性と可能性」

次世代配線板研究会2023年度公開研究会を開催致します。今回はLandless Viaの有効性と可能性にフォーカスして、専門家を講師に迎え最新の研究成果&技術動向を解説して頂きます。

開催日時 2024年2月21日(水) 13:00~17:00

開催方式 WEB研究会(Zoom Webinarシステム利用)

※参加URL等の聴講情報は、申込受付時のメールにてご連絡致します。

13:00~13:05

オープニング

開会挨拶 次世代配線板研究会

13:05~14:05

① 「ランドレスプリント配線板の優位性」

次世代配線板研究会 浦西 泰弘 氏

<概要>

近年の電子機器の小型化・高機能化および高性能化に対応するプリント配線板として、高密度実装を可能にする、ランドレスプリント配線板を考案した。その設計優位性を検討した結果およびデザインガイド案と製造課題の考察について報告する。

14:05~15:05

② 「Landless Viaの電気特性効果」

次世代配線板研究会(KEI Systems) 前田 真一 氏

<概要>

高速信号配線におけるビアは伝播信号の特性劣化の大きな原因となっている。このため、バックドリルやIVHなどビアによる特性劣化を抑える方法がとられている。ランドレスビアを使うことにより、ビアによる信号特性劣化をなくし、ビアを使わない配線だけの特性と変わらないことをシミュレーションを使って確認した。これにより、ランドレスビアは基板配線密度の向上だけでなく、電気特性的にも大きなアドバンテージがあることが証明された。ここでは、解析によるランドレスビアの特性向上について報告する。

(休憩10分)

15:15~16:05

③ 「壊れないマイクロビア接続のための無電解銅めっき技術」

奥野製薬工業株式会社 総合技術研究部 清水 優 氏

<概要>

半導体のチップレット3次元実装が進み、益々半導体サブストレートの微細多層化は進行する。このためマイクロビアの脆弱性はより顕在化することが予想される。本講演ではビア底に位置する内層銅-無電解銅めっき皮膜-硫酸銅めっき皮膜の銅-銅間の結晶方位をそろえる“結晶連続性”を実現でき、無電解銅めっき皮膜に存在する欠陥(ナノポイド)を抑制することができ、高信頼性が得られる無電解銅めっき技術を紹介致します。

16:05~16:55

④ 「電着フォトレジスト 基礎と応用」

DDPスペシャルティ・プロダクツ・ジャパン株式会社 米原 良 氏

<概要>

多くの分野で使用されている電着塗布によるマスキング法について基礎原理、特徴、適用例について説明します。応用については工法事例をお示しご紹介いたします。

(研究会からのコメント; DuPont社のグループ会社となった旧シプレイ社では長く電着フォトレジストの開発をおこなっている。電着は“landless Via”の作製に有効な手段の一つと考えられてきた。そこで、当研究会ではDuPont社の日本人にご講演をお願いしました。)

16:55~17:00 閉会挨拶

次世代配線板研究会

※プログラムは変更になることがありますので、ご了承ください。

参加要項

定 員 150名(先着申込順 定員になり次第締め切ります)

参加費(消費税込み)

正会員:5,000円、学生会員:1,000円、研究会会員:別払い、シニア会員:2,000円

名誉会員:無料、賛助会員の社員:5,000円、賛助会員(クーポン利用):無料

非会員一般:12,000円、非会員学生:2,000円、協賛団体(JPCA会員):5,000円

注意事項(参加方法)

- ①申込が受理されますと、**返信メールで公開研究会への参加 URLやお支払いに関する情報**をご連絡致します。
 - ②ご申請の手順に従って、参加費のお支払いをお願い致します。
(お支払い方法:銀行振込・クレジットカード決済)
 - ③請求書や振込確認後の領収書の発行は、返信メールのマイページから出力が可能です。
 - ④WEBの請求書が原紙扱いになりますので、ご了承ください。
 - ⑤賛助・特別クーポンは、1枚/1口まで(複数口の場合は口数分)利用可能です。申込時にクーポン番号等の全項目を記入しないと、利用できません。※複数枚使用希望がある場合はお問い合わせください。
 - ⑥参加費決済方法:クレジットカード決済か銀行振込をご選択いただけます。
銀行振込の場合の振り込み先は、マイページ「決済」タブより出力いただく請求書の下部をご確認ください。
- *キャンセルポリシー
お申込み後のキャンセルはできません。

下記から参加申し込みをお願いします。

会員

賛助会員

協賛会員

非会員

※クーポン使用の場合は「クーポン利用」をご選択ください。

問い合わせ先 一般社団法人エレクトロニクス実装学会

E-mail: info@jiep.or.jp

(メールアドレスは¥を@に置き換えてください)